**2023年度苏州工业园区集成电路产业发展专项资金申报书**

（2.6 支持品牌发展）

1. 项目基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | |  | | | | |
| 社会信用代码 | |  | | | | |
| 注册地址 | |  | | | | |
| 法定代表人 | |  | | 联系电话 |  | |
| 联系人 | |  | | 联系电话 |  | |
| 注册时间 | |  | | 注册资本  （万元） |  | |
| 企业介绍及主营业务概述（300字以内） | |  | | | | |
| 财务运营状况 | 指标/年份 | | 2021年 | | | 2022年 |
| 营业收入（万元） | |  | | |  |
| 企业净利润（万元） | |  | | |  |
| 展会/活动名称 | |  | | | | |
| 参展日期 | |  | | 参展费用 |  | |

1. 合同及发票清单
2. **合同清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 活动/展会名称 | 合同名称 | 签订日期 | 合同内容 | 合同金额（万元） |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合同金额合计（万元）： | | |  | | |

1. **发票清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 开票时间 | 发票编号 | 对应合同序号 | 开票金额（万） |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 发票总额（万元）： | |  | | |

1. 主办/参加展会介绍（规模、影响力、重要参展嘉宾等）
2. 其他证明材料